Power Assembly Engineer（パワーデバイスパッケージ）

Job Information

Hiring Company
iSoftStone

Job ID
1605945

Industry
Chemical, Raw Materials

Company Type
Large Company (more than 300 employees) - International Company

Non-Japanese Ratio
About half Japanese

Job Type
Contract

Location
Tokyo - 23 Wards

Salary
4.5 million yen ~ 6.5 million yen

Refreshed
September 10th, 2026 05:00

General Requirements

Minimum Experience Level
Over 1 year

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Daily Conversation

Minimum Japanese Level
Business Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

1. 高度なパワーエンカプラーシステム（材料およびプロセス）の開発を担当する
2. エンカプラー材料の専門家に対して、定期的なプロジェクトタスクの追跡をサポートできる
3. 材料の納品および分析作業において、専門家をサポートできる
4. 実験設計をサポートし、結果をまとめることができる

Required Skills

More than 2 years related working experience in encapsulate material/equipment/process technology development.